



# Call for Abstracts

Deutsche IMAPS Konferenz  
16. / 17. Oktober 2025, München

Im Herbst jeden Jahres veranstaltet IMAPS Deutschland eine Jahreskonferenz zu aktuellen Themen der Aufbau- und Verbindungstechnik in allen Anwendungsfeldern. Für die Sicherung, Stärkung und Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandorts Deutschlands möchte IMAPS Deutschland die Jahreskonferenz als eine wichtige Plattform für die dafür erforderliche engmaschige fachliche Diskussion zwischen Industrie und Hochschule sowie Produktion und Forschung verstanden wissen. Wir laden Sie deshalb auch in diesem Jahr wieder herzlich ein, Ihre Ergebnisse zu den nachfolgend genannten mikroelektronischen Packaging-Themen auf unserer Tagung vor Vertretern aus Industrie und Wissenschaft zu präsentieren und gemeinsam zu diskutieren (Vortrag 20 Minuten + Diskussion, Foliensatz für Teilnehmer, kein Full Paper erforderlich):

<p><b>Entwurf, Modellierung, Simulation</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elektrisches und elektromagnetisches Design</li> <li>• Thermisches und thermomechanisches Design</li> <li>• Fertigungs- und testgerechtes Design</li> <li>• HF Design und 3D-Entwurf</li> </ul>	<p><b>Materialien und Prozesse</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Substratmaterialien und Oberflächenschichtsysteme</li> <li>• Herstellung von Verdrahtungsträgern</li> <li>• Verbindungstechnologien (Flip Chip, CoB, SMT, Embedding, ...)</li> <li>• Schutz-, Verguss- und Verkapselungsprozesse und -materialien</li> <li>• Nanomaterialien</li> </ul>
<p><b>Technologien der Systemintegration</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wafer Level Packaging (CSP, SiP, ...)</li> <li>• Substrate Level Packaging (System on Board, Embedding, ...)</li> <li>• MEMS / Sensor-Packaging</li> <li>• Optoelektronisches Packaging</li> <li>• 3D-Packaging</li> </ul>	<p><b>Qualität und Zuverlässigkeit</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prozessüberwachung / Teststrategien</li> <li>• Prüfsysteme</li> <li>• Thermomechanische Zuverlässigkeit</li> <li>• Zuverlässigkeit bei kombinierten Beanspruchungen</li> <li>• Lebensdauermonitoring und -vorhersage</li> </ul>

Bitte senden Sie Ihren Abstract bis zum 21. Juli (ca. 200 Wörter) zur Bewertung ein. Bitte beachten Sie, dass alle Abstracts über den angegebenen Link in unserem Bewertungssystem registriert werden müssen.

<https://www.conftool.net/imaps-herbstkonferenz-2025/index.php>

Es wird wieder ein BEST PRESENTATION AWARD vergeben!



IMAPS Deutschland, Teil der "International Microelectronics and Packaging Society" (IMAPS), stellt seit 1973 in Deutschland das Forum für alle dar, die sich mit Mikroelektronik und Aufbau- und Verbindungstechnik beschäftigen. Mit knapp 250 Mitgliedern verfolgen wir drei Ziele: Wir verbinden Wissenschaft und Praxis, wir sorgen für den Informationsaustausch unter unseren Mitgliedern und wir vertreten den Standpunkt unserer Mitglieder in internationalen Gremien.

[www.imaps.de](http://www.imaps.de)